**Jetzt bei Distec: neues SMARC™ 2.1 Modul „conga-SA7“ von congatec**

**Kleines, robustes und leistungsstarkes Computer-on-Module für Industrie, Medizintechnik und Transportwesen**

Germering, 31. März 2022 – Die Distec GmbH – einer der führenden deutschen Spezialisten für TFT-Flachbildschirme und Systemlösungen für industrielle und multimediale Applikationen – nimmt das neue SMARC™ 2.1 Modul „conga-SA7“ von congatec ins Programm. Das SMARC™ Computer-on-Module ist mit dem neuen Intel® Elkhard Lake Prozessor Atom x6000E, Pentium® J6xxx und N6xxx bzw. mit dem Celeron® J6xxx und N6xxx erhältlich. „Klein, robust und leistungsstark“, beschreibt Thomas Schrefel, Produkt Manager Embedded bei Distec, das neue SMARC™ Modul. „Besonders beeindruckend sind die deutlich verbesserte Prozessor- und Grafikleistung von bis zu 200 Prozent bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch.“ Bei der neuen Prozessorarchitektur wurde laut Intel die Einzel-Thread-Leistung um das 1,7-fache, die Multi-Thread-Leistung um das 1,5-fache und die Grafik sogar um das Doppelte gesteigert. Das conga-SA7 lässt sich lüfterlos betreiben und widersteht rauen Umgebungen mit Vibrationen und Temperaturen von -40 °C bis +85 °C. Wer den industriellen Temperaturbereich nicht benötigt, kann auf die commercial Version von 0 °C bis +60 °C zurückgreifen. Das Modul ist damit prädestiniert für vielfältigste Anforderungen aus den Bereichen Medizintechnik, Transportwesen, Messtechnik und vielen mehr.

**Langzeitverfügbar und industrielle Qualität**

Das kompakte SMARC Modul mit Abmessungen von nur 82 auf 50 mm ist aktuell mit einer Verfügbarkeit bis mindestens 2030 geplant. Durch diese Langzeitverfügbarkeit, sein industrielles Design und den universellen SMARC Formfaktor bietet es hohe Flexibilität und beste Zuverlässigkeit für qualitativ hochwertige Anwendungen.

**Anschlussvielfalt auf kleiner Fläche**

Trotz seiner geringen Größe bietet das conga-SA7 mit seinem MXM3 Connector 314 Pins, um das Modul mit dem Carrier-Board zu verbinden. Es stehen DP++, zwei Gigabit-LAN-Ports mit TSN-Unterstützung, zwei USB 3.1 Gen2, sechs USB 2.0, SATA, bis zu 4 PCIe Lane, 4x UART, I2C und viele weitere Anschlüsse zur Verfügung. Außerdem bietet das conga-SA7 zwei onboard CAN-Schnittstellen. Optional ist das SMARC™ 2.1 Modul mit Wifi/BT, LVDS und/oder zusätzlichem DP++ erhältlich.

Für schnelle Entwicklungserfolge stehen derzeit von congatec zwei Carrier-Boards mit unterschiedlichem Funktionsumfang zur Verfügung.

Zeichen: 2.451

Keywords: Distec, congatec, conga-SA7, SMARC, Computer-on-Module, Intel, Elkhard Lake, Industrie, Medizintechnik, Transportwesen, Messtechnik, Digital Signage

Weitere Informationen und Datenblatt:

https://www.distec.de/produkte/computer-on-module/detail/congatec/conga-sa7/

**Bilder**

|  |  |
| --- | --- |
| Ein Bild, das Text, Elektronik, Schaltkreis enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Bild 1: Distec nimmt neues SMARC™ 2.1 Modul „conga-SA7“ von congatec ins Programm  Bildquelle/Copyright: congatec/Distec  Download: https://www.ahlendorf-news.com/media/news/images/distec-conga-sa7-smarc-H.jpg |
|  |  |
| Ein Bild, das Person, Wand, Anzug, drinnen enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Bild 2: Thomas Schrefel ist Product Manager Embedded bei Distec  Bildquelle/Copyright: Distec  Download: https://www.ahlendorf-news.com/media/news/images/Distec-Thomas-Schrefel-H.jpg |

**Über Distec**

Die Distec GmbH ist ein Unternehmen der FORTEC Group, weltweit agierender und anerkannter Spezialist im Bereich Display Technology und Embedded Computing für Projekte aus allen Branchen. Das Unternehmen mit Sitz in Germering bei München und einem Werk in Hörselberg-Hainich bei Eisenach, entwickelt, produziert und vermarktet innovative Lösungen und eine breite Auswahl an Komponenten, TFT-Displays, Embedded Boards, Systemen und Dienstleistungen. Die innovativen Lösungen von Baugruppen und Kits bis hin zum OEM-Endprodukt basieren auf Hard- und Software, die Distec im eigenen Designzentrum in Germering entwickelt. Distecs Dienstleistungsangebot umfasst neben kundenspezifischen Entwicklungen und Anpassungen, Produktveredelungen, wie dem VacuBond® Optical Bonding und der Assemblierung von Monitorsystemen auch die Herstellung von Fertigprodukten. Ein breites Angebot an Touchscreens und das interne Touch-Kompetenz-Zentrum ermöglichen individuelle Touch-Lösungen auch für schwierige Umgebungsbedingungen. Außerdem kann die Distec GmbH auf die Waren, Dienstleistungen und das Knowhow des umfangreichen FORTEC Hightech-Firmennetzwerks zurückgreifen. Weitere Informationen finden sich unter https://www.distec.de/

Die Produkte der Distec GmbH sind erhältlich bei:

Europa: Distec GmbH, Germering, https://www.distec.de/

UK und Benelux: Display Technology, Huntingdon, https://www.displaytechnology.co.uk/

Nordamerika: Apollo Display Technologies, Ronkonkoma NY, http://www.apollodisplays.com/

Türkei und naher Osten: DATA DISPLAY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD ŞTi., Istanbul

Distec GmbH

Augsburger Straße 2b

82110 Germering

Germany

T +49 89 894363 0

F +49 89 894363 131

E sales|at|distec.de

W www.distec.de

Ein Unternehmen der FORTEC Group

**Pressekontakt:**

Mandy Ahlendorf

ahlendorf communication

T +49 89 41109402

E ma@ahlendorf-communication.com